

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

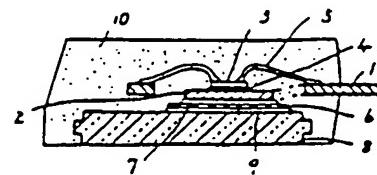
**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(54) RESIN-SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH
HEAT SINK

(11) 63-205935 (A) (43) 25.8.1988 (19) JP
(21) Appl. No. 62-37850 (22) 23.2.1987
(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO
(51) Int. Cl'. H01L23/28, H01L23/34

PURPOSE: To enhance the heat-dissipating performance and to reduce the ON resistance by a method wherein, after a circuit component has been mounted on a bed of a lead frame, it is fixed by laying a ceramic or the like between the bed and a heat sink so that this assembly can be resin-sealed.

CONSTITUTION: A semiconductor device 3 is fixed to a bed part 2 of a lead frame 1. Then, an electrode which has been formed on the semiconductor device 3 is connected to an external lead of the lead frame by using a metal thin wire 5. Then, a heat sink 8 is provided and Ag paste 9 is coated on one face of the heat sink a ceramic plate 6 is mounted on the face so as to be united in addition, an adhesive 7 is coated on the ceramic plate 6 the bed part 2 where the semiconductor device 3 is fixed is bonded to the ceramic plate. Then, this assembly is put in a metal mold and is sealed by using a mold resin 10 in such a way that one plane face of the heat sink 8 is exposed.



⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭63-205935

⑫ Int.Cl.

H 01 L 23/28
23/34

識別記号

厅内整理番号

B-6835-5F
B-6835-5F

⑬ 公開 昭和63年(1988)8月25日

審査請求 示請求 発明の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 放熱板付樹脂封止型半導体装置

⑮ 特 願 昭62-37850

⑯ 出 願 昭62(1987)2月23日

⑰ 発明者 加藤俊博 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

⑱ 出願人 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑲ 代理人 弁理士 井上一男

明細書

1. 発明の名称

放熱板付樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

半導体素子を固定する放熱性の良いリードフレームのベッド部を絶縁板を介して放熱板に一体に取付け、前記半導体素子の電極とこれに不連続状態で配置する外部リード間を接続する金属絶縁をもつ組立型を、前記放熱板の一面を露出して封止する樹脂層とを具備することを特徴とする放熱板付樹脂封止型半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の目的〕

(産業上の利用分野)

本発明はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを備える放熱板付樹脂封止型半導体装置の改良に関するものである。

(従来の技術)

パワートランジスタ等の電力用半導体素子を組立てるに当っては熱容量が大きくかつ放熱性に不足

だヒートシンク（放熱板を以後ヒートシンクと記載する）を利用する方式が採用されており、このヒートシンクに直接半導体素子を配置する際にはオン抵抗が大きな問題となる。

この解決策の一つとして第2回に示す方式即ち絶縁性がありしかも高い熱伝導を発揮するモールド樹脂の開発によって、半導体基板にパワートランジスタ等を造り込んだ素子20をダイボンディングしたリードフレーム21のベッド部22とヒートシンク間に、この高熱伝導特性をもつ封止樹脂層24を通じのトランスファーーモールド法によって充填する方法が実用化されている。

更に、特開昭60-160624号公報に開示されたヒートシンクと半導体素子の分離法を第3回イーエイによって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミドならびにエポキシ等の樹脂製フィルム25に接着剤26を塗布してから(第3回イ)、一定寸法に定型化したテープ27を第3回ロに示す自動方式によってマウントする。このテープ27は巻取りール28ならびに供給リール28に巻き取られ、基盤のヒータ

30で加熱されるヒートシンク31に、打抜きポンチ32を備えるプレス33を使用してテープ27をヒートシンク31に加熱圧着方式によって固定する。その後第3回ハに明らかなように、ヒートシンク31にはテープ27を介して半導体チップ34がペースト35によって実装して、ヒートシンク31と半導体チップ34は絶縁分離する。一方、パワートランジスタやトライアック等のように半導体基板の底面からの導通が必要な場合にはテープ27に予め蒸着等によるメタライズ処理や金属箔の貼付によって電極を設け、ここにこれらの素子をダイボンディングする方法が採られている。

(発明が解決しようとする問題点)

前述の第2回に示す方式では高熱放散性と電気絶縁性を両立させるには限界があった。と言うのはリードフレームのベッド部22とヒートシンク23間の距離を加えて高熱放散性を確保しようとすると、この間際に充填する封止樹脂層24に空隙が発生して電気絶縁性に難点を生じるので、両者間の距離として約0.6mm以下に近づけることは事実上

無理となる。

第3回に示す電子分離方式は有機絶縁物からなるテープを利用しているが、高熱放散性が不充分言い換えると熱抵抗が悪く、従ってパワーが大きく発熱量が大きい半導体素子の組立には難点がある。

本発明は、上記難点を克服する現状な放熱板付樹脂封止型半導体装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

この目的を達成するために、本発明ではリードフレームのベッドに必要な半導体素子などの電子回路部品を収容してからこのベッドとヒートシンク間にセラミック等の絶縁物層を介在して固着後、常法通り樹脂で封止することによって、熱放散性に優れかつオシ抵抗の少ない樹脂封止型半導体装置を得るものである。

(作用)

このようにリードフレームのベッドとヒートシ

ンク間にセラミック等の絶縁物層を介在して得られる樹脂封止型半導体装置は熱抵抗が0.9°C/Vと極めて小さくなる事実を基に完成したもので、従来の技術欄に説明した第2回の樹脂封止型半導体装置(5mm口の半導体素子使用)の熱抵抗4.5°C/Vに比べて際立った効果を示し、その優位性は明らかである。

(実施例)

第1回により実施例を詳述するが、従来の技術欄と重複する記載も都合上あるが、新番号を付して説明する。

先ずリードフレーム1を備備するが、そのベッド部2に搭載する半導体素子3の機種に応じてこのリードフレーム1の型も選定されるのは当然で、ピン数の多い半導体素子3では常法に従ってデュアルインラインタイプのリードフレームを適用し、ここに半田等4を利用して半導体素子3をベッド部2に固定する。次に、この半導体素子3に設ける電極とリードフレームの外部リード間を金属網5によって接続して電気的導通を図る。ここで、

このリードフレームの材質としては鋼もしくは銅合金を使用することを強調しておく。この鋼系リードフレームを適用しているので、その搬送時には、酸化防止に充分留意して金属網5によるボンディング工程に支障なきよう、又ボンディング工程時にもリードフレームの酸化防止に努めるのも必要である。

次に相対向する平坦な面を備えたヒートシンク8を用意し、その一面にAeペースト層9を被着し、ここにセラミック板6を載せて一体化し、更にこのセラミック板6に矢張りAeペースト等の接着剤7を塗って、ここに前述の通り半導体素子3を固定した鋼もしくは銅合金製のリードフレームベッド部2を配置して合体する。

このセラミック板は0.6mm程度に形成し、半導体素子の大きさが6×6mm程度なら約10mm角とし、材質としてはAl₂O₃、AlN、SiC、ならびにBeO等何れも適用できる。尚、セラミック板6の一体化に当っては有機接着剤にかえてガラス接着剤も使用可である。次に、トランスファー・モールド成型に

この相立体を入れて、ヒートシンク8の一方の平坦な面が露出するようにモールド樹脂10によって封止する。

この樹脂としては熱伝導率 $\lambda = 60 \sim 100 \times 10^{-4}$ cal/cm sec $^{\circ}\text{C}$ を示す高熱導率でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

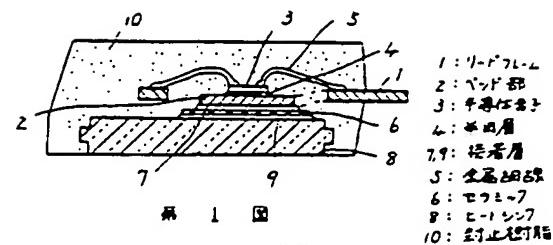
(発明の効果)

このように本発明に係る放熱板付樹脂封止型半導体装置ではその適用材料に熱放散性が優れたりードフレームや封止樹脂を採用するのは勿論として、ヒートシンクと、半導体素子をマウントするリードフレームのベッド部間にセラミックを介在させて熱抵抗の低減化を達成して高出力のパワーモジュールを製造したものである。

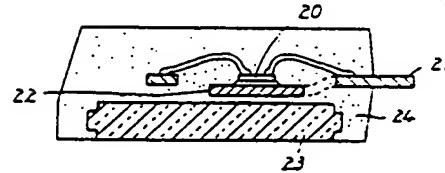
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る放熱板付樹脂封止型半導体装置の要部を示す断面図、第2図は従来装置の断面図、第3図イ～ハはヒートシンクと半導体素子の分離に絶縁シート適用例の工程を示す断面図である。

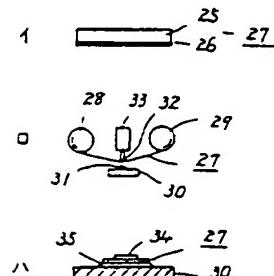
代理人弁理士井上一男



第1図



第2図



第3図